

中国集成电路（IC）制造行业发展现状及投资策略建议报告2022-2027年

产品名称	中国集成电路（IC）制造行业发展现状及投资策略建议报告2022-2027年
公司名称	北京中研华泰信息技术研究院
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区北苑东路19号中国铁建大厦
联系电话	010-56231698 18766830652

产品详情

中国集成电路（IC）制造行业发展现状及投资策略建议报告2022-2027年*****
*****【报告编号】 339364【出版日期】 2022年3月【出版机构】
中研华泰研究院【交付方式】 EMIL电子版或特快专递【报告价格】 纸质版:6500元 电子版:6800元
纸质版+电子版:7000元【联系人员】
刘亚 免费售后服务一年，具体内容及订购流程欢迎咨询客服人员 章 IC行业介绍1.1
IC相关组成部分1.1.1 存储器1.1.2 逻辑电路1.1.3 微处理器1.1.4 模拟电路1.2 IC制造工艺1.2.1
热处理工艺1.2.2 光刻工艺1.2.3 刻蚀工艺1.2.4 离子注入工艺1.2.5 薄膜沉积工艺1.2.6 清洗1.3
IC制造相关链结构1.3.1 上游设计环节1.3.2 中游制造环节1.3.3 下游封测环节1.4 IC相关制造模式1.4.1
IDM模式1.4.2 Foundry模式1.4.3 Chipless模式第二章 2020-2022年全球IC制造行业运行情况2.1
全球IC制造业发展概况2.1.1 IC制造市场运行现状2.1.2 全球IC制造竞争格局2.1.3 全球IC制造工艺发展2.1.4
全球IC制造企业发展2.1.5 IC制造部件发展态势2.2 全球IC制造业技术专利2.2.1 全球申请趋势分析2.2.2
优先权的国家分析2.2.3 主要的申请人分析2.2.4 技全球术区域分析2.3 全球集成电路产业发展2.3.1 美国2.3.2
日本2.3.3 欧洲2.3.4 亚太第三章 2020-2022年中国IC制造发展环境分析3.1 经济环境3.1.1 国际宏观经济3.1.2
国内宏观经济3.1.3 工业运行情况3.1.4 宏观经济展望3.2 社会环境3.2.1 人口结构分析3.2.2 居民收入水平3.2.3
居民消费水平3.3 投资环境3.3.1 固定资产投资3.3.2 社会融资规模3.3.3 财政收支安排3.3.4
地方投资计划第四章 2020-2022年中国IC制造政策环境分析4.1 国家政策解读4.1.1
产业高质量发展政策4.1.2 企业所得税纳税公告4.1.3 产业质量提的意见4.1.4 职业技能提升计划4.1.5
制造能力提升计划4.2 IC行业相关标准分析4.2.1 IC标准组织4.2.2 IC国家标准4.2.3 行业IC标准4.2.4
团体IC标准4.2.5 IC标准现状4.3 “十四五” IC产业政策4.3.1 注重工艺制造人才的引进4.3.2
半导体投资不宜盲目跟风4.3.3 加大关键设备国产化支持第五章 2020-2022年中国IC制造行业运行情况5.1
中国IC制造业整体发展概况5.1.1 IC制造业产业背景5.1.2 IC制造业发展规律5.1.3 IC制造业相关特点5.1.4
IC制造业发展逻辑5.2 中国IC制造业发展现状分析5.2.1 IC制造各环节设备5.2.2 IC制造业发展现状5.2.3
IC制造业销售规模5.2.4 IC制造业市场占比5.2.5 IC制造业未来增量5.2.6 IC制造业水平对比5.3
台湾IC制造行业运行分析5.3.1 台湾IC制造发展历程5.3.2 台湾IC制造产业份额5.3.3
台湾IC制造产值分布5.3.4 台湾重点IC制造公司5.3.5 台湾IC产值未来预测5.4
2020-2022年中国集成电路进出口数据分析5.4.1 进出口总量数据分析5.4.2 主要贸易国进出口情况分析5.4.3
主要省市进出口情况分析5.5 IC制造业面临的问题与挑战5.5.1 IC制造业面临问题5.5.2

IC制造业生态问题5.5.3 IC制造业发展挑战5.6 IC制造业发展的对策与建议5.6.1 IC制造业发展策略5.6.2 IC制造业生态对策5.6.3 IC制造业政策建议第六章 IC制造产业链介绍6.1.1 IC制造产业链整体介绍6.1.2 上游——原料和设备6.1.3 中游——制造和封装6.1.4 下游——应用市场6.2 设计市场发展现状分析6.2.1 IC设计企业整体运行6.2.2 IC设计市场规模分析6.2.3 IC设计公司数量变化6.2.4 IC设计市场存在问题6.2.5 IC设计行业机遇分析6.3 封装市场发展现状分析6.3.1 封装市场基本概述6.3.2 半导体封装历程6.3.3 半导体封装规模6.3.4 半导体封装工艺6.3.5 先进封装市场运行6.3.6 封装市场发展方向6.4 测试市场发展现状分析6.4.1 IC测试内容6.4.2 IC测试规模6.4.3 IC测试厂商6.4.4 IC测试趋势第七章 2020-2022年IC制造相关材料市场分析7.1 IC材料市场整体运行分析7.1.1 全球IC材料市场发展7.1.2 中国IC材料市场发展7.1.3 IC材料市场发展思路7.1.4 IC材料产业现存问题7.1.5 IC材料市场发展目标7.1.6 IC材料产业发展展望7.2 硅片材料7.2.1 硅片制造工艺7.2.2 硅片制造方法7.2.3 市场运行情况7.2.4 硅片产业机遇7.2.5 硅片产业挑战7.3 光刻材料7.3.1 光刻胶发展历程7.3.2 光刻材料的组成7.3.3 光刻胶整体市场7.3.4 光刻胶发展现状7.3.5 光刻胶国产化率7.3.6 光刻胶市场竞争7.3.7 光刻胶产业特点7.3.8 光刻胶产业问题7.3.9 光刻胶提升方面7.3.10 光刻胶发展建议7.4 抛光材料7.4.1 主要抛光材料介绍7.4.2 抛光材料行业规模7.4.3 材料市场竞争格局7.4.4 抛光材料企业介绍7.4.5 抛光材料市场趋势7.5 其他材料市场分析7.5.1 掩模版7.5.2 湿化学品7.5.3 电子气体7.5.4 靶材及蒸发材料7.6 材料市场重大工程建设7.6.1 IC关键材料及装备自主可控工程7.6.2 相关材料、工艺及装备验证平台7.6.3 先进半导体材料在终端领域应用7.7 材料市场发展对策建议7.7.1 抓住战略发展机遇期7.7.2 布局下一代的IC技术7.7.3 构建产业技术创新链第八章 2020-2022年IC制造环节设备市场分析8.1 半导体设备8.1.1 全球半导体设备规模8.1.2 中国半导体设备规模8.1.3 半导体设备国产化率8.1.4 半导体设备政策支持8.1.5 半导体设备市场格局8.1.6 半导体设备主要产商8.1.7 半导体设备投资分析8.1.8 半导体设备规模预测8.2 晶圆制造设备8.2.1 晶圆制造设备主要类型8.2.2 晶圆制造设备市场规模8.2.3 晶圆制造设备竞争格局8.2.4 设备细分市场分布情况8.2.5 晶圆制造设备占比分析8.3 光刻机设备8.3.1 光刻机发展历程8.3.2 光刻机的产业链8.3.3 光刻机设备占比8.3.4 光刻机市场规模8.3.5 光刻机市场增量8.3.6 光刻机竞争格局8.3.7 光刻机供应市场8.3.8 光刻机出货情况8.4 刻蚀机设备8.4.1 刻蚀机的主要分类8.4.2 刻蚀机的市场规模8.4.3 刻蚀机市场集中度8.4.4 刻蚀机的国产替代8.4.5 刻蚀机的规模预测8.5 硅片制造设备8.5.1 制造设备简介8.5.2 市场厂商分布8.5.3 主要设备涉及8.5.4 设备市场规模8.5.5 设备市场项目8.6 检测设备8.6.1 检测设备主要分类8.6.2 检测设备市场规模8.6.3 检测设备市场格局8.6.4 工艺检测设备分析8.6.5 晶圆检测设备分析8.6.6 FT测试设备分析8.7 中国IC设备企业8.7.1 屹唐半导体科技有限公司8.7.2 中国电子科技集团有限公司8.7.3 盛美半导体设备股份有限公司8.7.4 北方华创科技集团股份有限公司第九章 2020-2022年晶圆制造厂具体市场分析9.1 晶圆制造厂市场运行分析9.1.1 全球晶圆制造产能9.1.2 全球晶圆厂发开支9.1.3 中国晶圆厂的建设9.1.4 晶圆厂的市场招标9.1.5 晶圆制造产能预测9.2 晶圆代工厂市场运行分析9.2.1 全球晶圆代工市场规模9.2.2 全球晶圆代工企业排名9.2.3 全球晶圆代工工厂扩产9.2.4 中国晶圆代工市场规模9.2.5 中国晶圆代工企业排名9.2.6 中国晶圆代工工厂建设9.3 中国晶圆厂生产线分布9.3.1 12英寸(300mm)晶圆生产线9.3.2 8英寸(200mm)晶圆生产线9.3.3 6英寸及以下尺寸晶圆生产线9.3.4 化合物半导体晶圆生产线9.4 晶圆厂建设市场机遇9.4.1 供给端来看9.4.2 需求端来看第十章 2020-2022年IC制造相关技术分析10.1 IC制造技术指标10.1.1 集成度10.1.2 特征尺寸10.1.3 晶片直径10.1.4 封装10.2 化学机械抛光CMP10.2.1 化学机械研磨CMP10.2.2 CMP国产化现状10.2.3 CMP国产化协作10.3 光刻技术10.3.1 光刻技术耗时10.3.2 光刻技术内涵10.3.3 光刻技术工艺10.4 刻蚀技术10.4.1 刻蚀技术简介10.4.2 主流刻蚀技术10.4.3 刻蚀技术壁垒10.5 IC技术发展趋势10.5.1 尺寸逐渐变小10.5.2 新技术和材料10.5.3 新领域的运用第十一章 2020-2022年IC制造行业建设项目分析11.1 精测电子——研发及产业化建设项目11.1.1 项目概况11.1.2 项目必要性分析11.1.3 项目可行性分析11.1.4 项目投资概算11.2 利扬芯片——芯片测试产能建设项目11.2.1 项目概况11.2.2 项目必要性分析11.2.3 项目可行性分析11.2.4 项目投资概算11.3 深科技——存储先进封测与模组制造项目11.3.1 项目基本情况11.3.2 项目必要性分析11.3.3 项目可行性分析11.3.4 项目投资概算11.4 来尔科技——晶圆制程保护膜产业化建设项目11.4.1 项目必要性分析11.4.2 项目投资概算11.4.3 项目周期进度11.4.4 审批备案情况11.5 赛微电子——8英寸MEMS国际代工线建设项目11.5.1 项目基本情况11.5.2 项目必要性分析11.5.3 项目可行性分析11.5.4 项目投资概算11.5.5 项目经济效益第十二章 2019-2022年国外IC制造重点企业介绍12.1 英特尔(Intel)12.1.1 企业发展概况12.1.2 2019财年企业经营状况分析12.1.3 2020财年企业经营状况分析12.1.4 2021财年企业经营状况分析12.2 三星电子(Samsung Electronics)12.2.1 企业发展概况12.2.2

2019年企业经营状况分析12.2.3 2020年企业经营状况分析12.2.4 2021年企业经营状况分析12.3
德州仪器 (Texas Instruments) 12.3.1 企业发展概况12.3.2 2019年企业经营状况分析12.3.3
2020年企业经营状况分析12.3.4 2021年企业经营状况分析12.4 SK海力士 (SK hynix) 12.4.1
企业发展概况12.4.2 2019年海力士经营状况分析12.4.3 2020年海力士经营状况分析12.4.4
2021年海力士经营状况分析12.5 安森美半导体 (On Semiconductor) 12.5.1 企业发展概况12.5.2
2019财年企业经营状况分析12.5.3 2020财年企业经营状况分析12.5.4 2021财年企业经营状况分析第十三章
2019-2022年国内IC制造重点企业介绍13.1 台湾积体电路制造公司13.1.1 企业发展概况13.1.2
2019年企业经营状况分析13.1.3 2020年企业经营状况分析13.1.4 2021年企业经营状况分析13.2
华润微电子有限公司13.2.1 企业发展概况13.2.2 经营效益分析13.2.3 业务经营分析13.2.4 财务状况分析13.2.5
核心竞争力分析13.2.6 公司发展战略13.2.7 未来前景展望13.3 沈阳芯源微电子设备股份有限公司13.3.1
企业发展概况13.3.2 经营效益分析13.3.3 业务经营分析13.3.4 财务状况分析13.3.5 核心竞争力分析13.3.6
公司发展战略13.3.7 未来前景展望13.4 中芯国际集成电路制造有限公司13.4.1 企业发展概况13.4.2
经营效益分析13.4.3 业务经营分析13.4.4 财务状况分析13.4.5 核心竞争力分析13.4.6 公司发展战略13.4.7
未来前景展望13.5 闻泰科技股份有限公司13.5.1 企业发展概况13.5.2 经营效益分析13.5.3
业务经营分析13.5.4 财务状况分析13.5.5 核心竞争力分析13.5.6 公司发展战略13.5.7 未来前景展望第十四章
2020-2022年IC制造业的投资市场分析14.1 IC产业投资分析14.1.1 IC产业投资基金14.1.2
IC产业投资机会14.1.3 IC产业投资问题14.1.4 IC产业投资思考14.2 IC投资基金介绍14.2.1
IC投资资金来源14.2.2 IC投资具体项目14.2.3 IC投资基金营收14.2.4 IC投资市场动态14.3
IC制造投资分析14.3.1 投资的整体市场14.3.2 IC制造融资市场14.3.3 IC制造投资项目第十五章
2022-2027年IC制造行业趋势分析15.1 IC制造业发展的目标与机遇15.1.1 IC制造业发展目标15.1.2
IC制造业发展趋势15.1.3 IC制造业崛起机遇15.1.4 IC制造业发展机遇15.2
2022-2027年中国集成电路制造产业预测分析15.2.1 2022-2027年中国集成电路制造产业影响因素分析15.2.2
2022-2027年中国集成电路制造业销售规模预测图表目录图表1 晶圆制造流程图表2 氧化工艺的用途图表3
光刻工艺流程图图表4 光刻工艺流程简介图表5 湿法刻蚀和干法刻蚀对比图表6
具有多晶硅栅和铝金属化CMOS芯片刻蚀工艺图表7 离子注入与扩散工艺比较图表8
CVD与PVD工艺比较图表9 化学薄膜沉积工艺过程图表10 三种CVD工艺对比图表11
半导体清洗的污染物种类、来源及危害图表12 IDM模式流程图图表13
2019年全球IC制造产业市场竞争格局分析图表14 2020年全球IC制造公司排名情况图表15
2021年增长快的IC部件预测图表16 2019年IC制造领域检索关键词列表图表17
2000-2019年全球IC制造专利家族计数图表18 2019年全球专利家族状况图表19
2019年全球专利按专利权人分类图图表20 2019年IC制造领域全球专利专利权人按国家分布图图表21
2019年IC制造领域全球专利数量区域分布情况图表22 2016-2020年国内生产总值及其增长速度图表23
2016-2020年三次产业增加值占国内生产总值比重图表24 2019年主要工业产品产量及其增长速度图表25
2016-2020年全部工业增加值及其增长速度图表26 2020年主要工业产品产量及其增长速度图表27
2019年全国居民人均可支配收入平均数与中位数图表28
2020年全国居民人均可支配收入平均数与中位数图表29 2019年全国居民人均消费支出及构成图表30
2020年全国居民人均消费支出及构成图表31 2019年固定资产投资 (不含农户) 同比增速图表32
2019年固定资产投资 (不含农户) 主要数据图表33 2020年固定资产投资 (不含农户) 同比增速图表34
2020年固定资产投资 (不含农户) 主要数据图表35 2020年相关省市重大项目投资计划图表36
2020年相关省市重大项目投资计划 (续一) 图表37 2020年相关省市重大项目投资计划 (续二) 图表38
全国集成电路标准化技术委员会单位名单图表39
全国集成电路标准化技术委员会单位名单 (续一) 图表40
全国集成电路标准化技术委员会单位名单 (续一) 图表41 IC制造各环节设备对应国内外企业名单图表42
2016-2020年中国集成电路制造业销售额及增长率图表43 2020年中国IC制造业市场占比情况图表44
2019年全球晶圆代工厂销售额排名图表45 2020年台湾IC细分产业在全球IC产业占比情况图表46
2019-2021年中国主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置进出口总额图表47
2019-2021年中国主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置进出口结构图表48
2019-2021年中国主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置贸易逆差规模图表49
2019-2020年中国主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置进口区域分布图表50
2019-2020年中国主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置进口市场集中度 (分国家) 图表51
2020年主要贸易国主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置进口市场情况图表52

2021年主要贸易国主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置进口市场情况图表53
2019-2020年中国主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置出口区域分布图表54
2019-2020年中国主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置出口市场集中度（分国家）图表55
2020年主要贸易国主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置出口市场情况图表56
2021年主要贸易国主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置出口市场情况图表57
2019-2020年主要省市主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置进口市场集中度（分省市）图表58
2020年主要省市主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置进口情况图表59
2021年主要省市主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置进口情况图表60
2019-2020年中国主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置出口市场集中度（分省市）图表61
2020年主要省市主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置出口情况图表62
2021年主要省市主要用于制造集成电路或平板显示器等的机器及装置出口情况图表63
IC制造产业链图表64
2011-2020年中国IC设计业销售市场规模分析图表65
2015-2020年中国集成电路设计公司数量变化图表66
半导体封装技术的发展历史图表67
2018-2024年全球半导体先进封装规模及预测图表68
半导体封装工序及特征分析图表69
IC测试项目及内容图表70
2010-2019年中国IC测试市场规模图表71
集成电路测试市场的主要厂商图表72
半导体硅片制造工艺简介图表73
直拉单晶制造法图表74
不同类型光刻胶的国产化情况图表75
不同类型光刻胶的国产化情况图表76
中国光刻胶国产化率情况图表77
2016-2019年全球抛光垫及抛光液市场规模统计图表78
2019年全球CMP抛光液市占率图表79
2019年全球CMP抛光垫市占率